

INVESTOR RELATIONS

2021년 3분기

Your Most trustworthy



유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

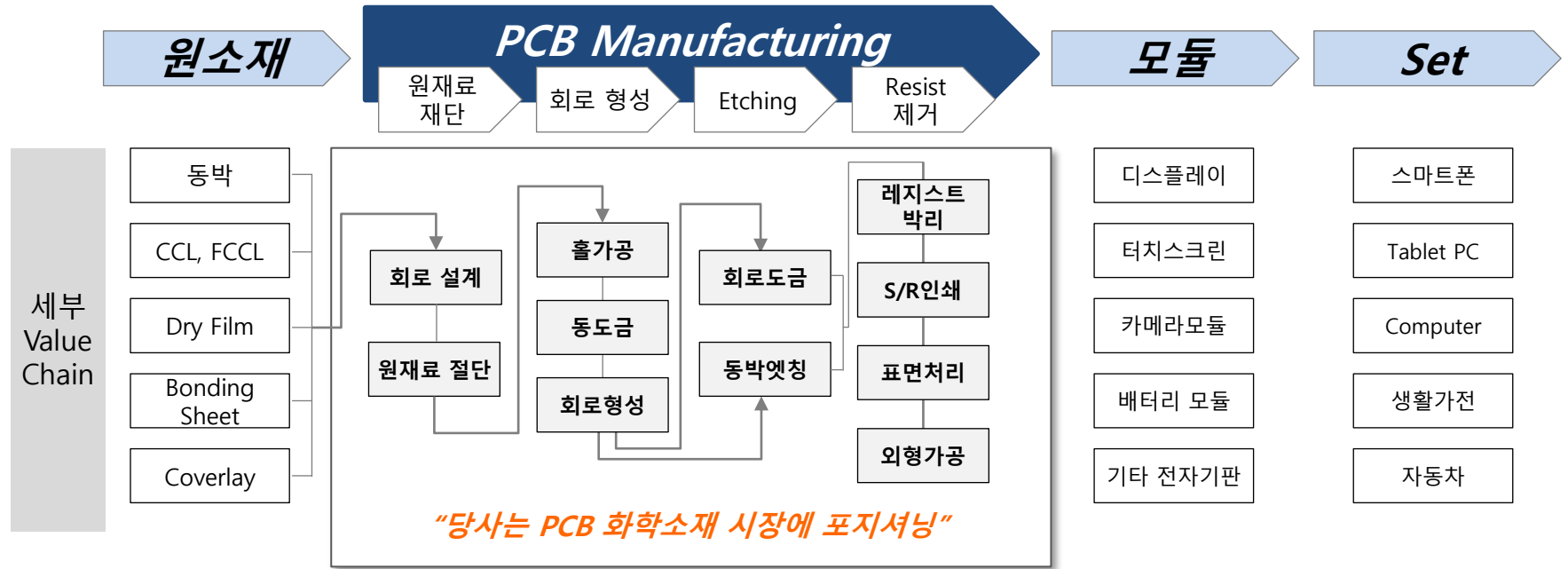
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



PCB Industry value chain



당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.

주요고객사 (Major Customer)

“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대중”

FPCB Customer	   
	   
	   
PKG Substrate	   

Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정, 박리제 부터 최종 표면처리 까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다. 이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



Final Finishing Chemical

Soft ENIG Process

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

ENIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

ENEPIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

EPIG process

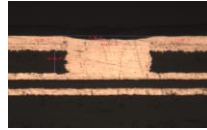
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

Immersion process

- ✓ PROTIN Series

Electrolytic gold process

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



Copper plating chemical

Electroless Copper plating

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

Electrolytic Copper plating

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



Process Chemical

DES Chemical

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

Cleaner

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

Gold Recover

UBM Etchant

LAZ Process



New product for 5G

No etching and roughness laminating pretreatment

Ultra low profile detachable thin copper foil

Positive Cu roughening

Process Nanotus®

Electroless Copper plating for LCP

Domestic Market situation

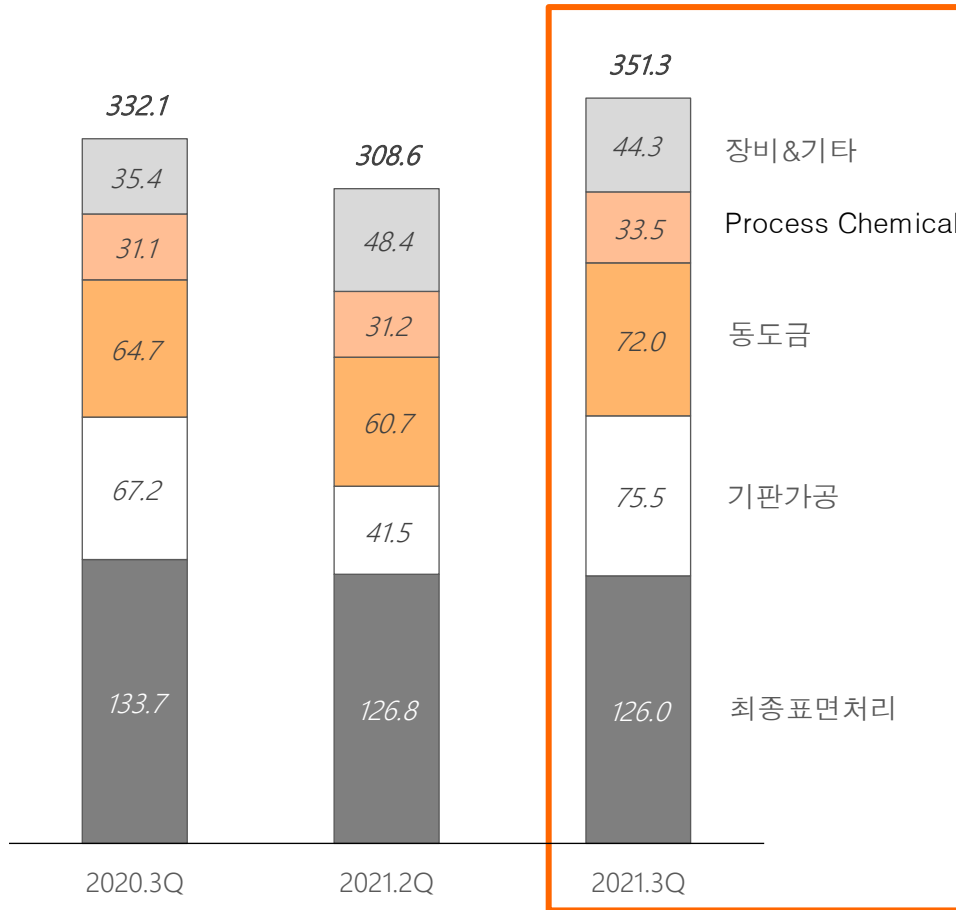
신규 사업분야

기존 사업분야

		"기존 사업영역"		"21년 신규진입분야"					
		FPCB, RFPCB		PKG		HDI		RIGID	
Major player	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> SEMCO BH Flex Youngpoong Daeduck 	<ul style="list-style-type: none"> SEMCO Daeduck SIMTECH Korea Circuit 	<ul style="list-style-type: none"> Daeduck LG Innoteck Korea Circuit 	<ul style="list-style-type: none"> Hyunwoo SEIL 				
	Global	<ul style="list-style-type: none"> Zhending Technology Career Unimicron Mektron 	<ul style="list-style-type: none"> AT&S Zhending Technology Ibiden 	<ul style="list-style-type: none"> AT&S Zhending Technology Ibiden 	<ul style="list-style-type: none"> Various 				
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> 점유율 확대중 Fine pattern 용 고부가가치 박리액 등 프로모션 	<ul style="list-style-type: none"> 고객사 및 라인 확대중 Fine Pitch 및 MSAP 약품 주력 	<ul style="list-style-type: none"> 박리 / 에칭 관련 매출 확대중 	<ul style="list-style-type: none"> - 				
Cu Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> 국내 높은수준의 점유율 보유 (40% 이상 추정) 	<ul style="list-style-type: none"> 심택 / TLB 공급중 추가적인 Major 고객사 테스트중 	<ul style="list-style-type: none"> 국내 HDI 업체 프로모션 중 	<ul style="list-style-type: none"> - 				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> 외주를 통한 양산 	<ul style="list-style-type: none"> 외주공정을 통한 양산 매출 발생 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 	<ul style="list-style-type: none"> - 				
최종표면처리	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> 금도금 분야 전세계 1위 점유율 확보 (50%이상) 	<ul style="list-style-type: none"> 고객사 평가중 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 	<ul style="list-style-type: none"> 일부 국내 고객사 거래중 				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> 베트남 시장 전해금도금 외주물량 확대 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 				

Sales Result

■ 최종표면처리 □ 기판가공 ■ 동도금 ■ Process Chemical □ 기타 및 장비 (단위: 억원)



• 21년 3Q 매출액 351.3억원으로 역대 최대 매출 달성

- ✓ 20년 3Q 대비 19.2억원 / 5.8% 성장
- ✓ 실질적 매출 성장이 아닌 팔라듐 가격의 상승으로 인한 매출상승
(Pd가격/oz : 20년 3분기 평균 \$2,168 → 21년 3분기 평균 \$2,459)

• 북미 스마트폰 생산차질로 인한 순매출 감소

- ✓ OLED 용 RFPCB는 계획대로 공급이 되었으나, 중국 현지에서 조달하는 FPCB 생산량이 감소
- ✓ 이로 인한 약품 매출이 4분기로 지연 (다음장 자세히)

• 베트남 법인 및 기판가공 매출 확대

- ✓ 베트남: 20.3Q 94.4억원 → 21.3Q 100.5억원
- ✓ YPT: 20.3Q 41.1억원 → 21.3Q 46억원
- ✓ 베트남 법인 도금사업부 흑자전환

Appendix



- 스마트폰 1대당 보통 12개~14개의 RFPCB가 사용되고 있음
- 이중 OLED Display 용 RFPCB(2개)는 한국 제조사를 통해 공급되고 있으나, 나머지는 중국 LOCAL 고객사를 통해 공급받고 있음
- 중국 현지에서 공급받는 FPCB는 현지 아이폰 생산 스케줄에 연동되는 바, 현재 반도체 공급 부족으로 생산이 지연되어 당사의 3분기 매출도 감소하였음.

2021년 4분기 전망

아이폰 13 FPCB / RFPCB 양산 지속

- 반도체 부족으로 생산이 지연된 바 4분기로 이연되어 매출이 지속발생할 것으로 예상됨

PKG 고객사 (동도금) 확대

- 현재 심텍, TLB 를 주 거래선으로 PKG 시장에서 동도금 화학소재를 확대 중에 있음
- 하반기 국내 Major 업체 추가 전망 (현재 다수의 업체 Test중)

100% Cu mask 본격 확대

- 광고 심의 및 모델 선정, 그리고 시장 분석의 이유로 3분기 광고집행 Holding.
- 마스크 외 담요, 패션용품 등 콜라보레이션 진행 중

신규 계열사 SPMaterials 설립

- 해외 및 국내 대기업 출신의 상사인력으로 구성
- 알루미늄박, 특수 원자재 등의 전자재료 분야에서 사업 진행

Overseas

- 21년 말 중국 주하이 공장 (약품생산 & 외주도금) 완공, 22년 양산 및 외주도금 매출 목표
- 베트남 법인의 지속적인 매출 증가

Income Statement

(단위:억원)

	제 23기 3분기	매출비중	제 22기 3분기	매출비중
I. 매출액	928.4	100%	818.0	100%
II. 매출원가	647.1	69.7%	521.0	63.7%
III. 매출총이익	281.3	30.3%	297.0	36.3%
판매비와 관리비	124.5	13.4%	109.6	13.4%
IV. 영업이익	156.8	16.9%	187.4	22.9%
금융수익	50.4	5.4%	24.5	3.0%
금융비용	48.0	5.2%	22.4	2.7%
기타수익	5.0	0.5%	6.1	0.7%
기타비용	2.8	0.3%	1.5	0.2%
지분법손익	0.0	0.0%	-1.4	-0.2%
V. 법인세차감전순이익	161.4	17.4%	192.7	23.6%
법인세비용	31.8	3.4%	25.4	3.1%
VI. 당기순이익	129.6	14.0%	167.3	20.5%

주요 수익성 지표

	제23기 3분기	제22기 3분기
영업이익률	16.9%	22.9%
순이익률	14.0%	20.5%
EBITDA (마진율)	207.0 (22.3%)	230.6 (28.2%)
ROE	8.6%	13.8%

- ① 원가율 상승
 - 귀금속 원재료 제품(팔라듐 촉매제)의 비중 상승
 - 제조경비(연구개발비, 감가상각비, 노무비)의 증가
 - PGC 상품 비중 증가
 - 재고자산평가차손 결산반영
- ② 판관비 상승
 - 인건비(6.4억) 증가 (주식보상비용 3.5억 포함)
 - 대손상각비, 견본비, 소모품비, 복리후생비 증가
- ③ 영업외손익
 - 외환차익/환산손익(38.8억)
 - 3CB 상황에 따른 사채상환손실(3.8억)
 - 4CB 평가에 따른 파생상품평가손실(18.7억)

Balance Sheet

(단위:억원)

	제 23기 3분기	제 22기
자산		
현금성자산	565.4	556.4
매출채권	291.1	266.0
유형자산	898.5	769.5
기타자산	476.0	392.7
자산총계	2,231.0	1,984.6
부채		
매입채무	37.8	34.2
차입금	545.2	496.3
전환사채	92.0	122.1
기타부채	187.3	151.5
부채총계	862.3	804.1
자본		
자본금	74.8	74.8
자본잉여금	249.4	249.4
기타자본	31.4	(6.1)
이익잉여금	763.0	674.8
비지배지분	250.1	187.6
자본총계	1,368.7	1,180.5
부채와자본 계	2,231.0	1,984.6

Cash Flow

(단위:억원)

	제 23기 3분기	제 22기 3분기
기초현금	556.4	417.5
영업활동으로 인한 현금흐름	145.8	187.9
순이익	129.5	167.2
감가상각비	41.6	35.1
이자비용	15.9	14.0
파생상품평가손실	18.7	-
법인세비용	31.7	25.3
외화환산이익	(27.8)	(1.2)
자산부채의 변동	77.1	35.1
기타	(140.9)	(87.6)
투자활동으로 인한 현금흐름	(184.8)	(84.6)
유무형자산의 취득/처분	(164.7)	(61.1)
기타	(20.1)	(23.5)
재무활동으로 인한 현금흐름	8.7	(12.4)
차입금 증감	48.9	(24.8)
자기주식의 처분	-	21.7
전환사채의 상환	(40.0)	-
기타	(0.2)	(9.3)
현금증감	(30.3)	90.9
환율변동효과	39.3	1.3
기말현금	565.4	509.7